



NXP, AWS 그린그래스 통합한 보안 엣지 프로세싱 · 머신 러닝 제품 선보여

2017년 11월 28일 - NXP 반도체는 다양한 IoT 및 보안 엣지 프로세싱 애플리케이션에 탑재된 자사의 마이크로프로세서(MPUs)와 마이크로컨트롤러(MCUs), 애플리케이션 프로세서를 AWS 리인벤트 2017(AWS re:Invent 2017)에서 선보인다고 밝혔다. 이 제품들은 NXP 레이어스케이프(Layerscape), i.MX 애플리케이션 프로세서 및 LPC MCU 제품군 상에서 운영된다. 보안 엣지 프로세싱은 지연 시간과 대역폭을 낮춰줄 뿐 아니라 IoT 솔루션의 보안성을 향상시킨다.

현재 상용되는 IoT 는 엣지 프로세싱과 보안 모두를 필요로 한다. AWS 에 연결된 엣지 프로세싱 디바이스를 지원하고 작동하기 위해 보안 프로비저닝, 커넥티비티, 프로세싱이 필요하다. 이를 위해 NXP 는 이 세 가지 기능을 모두 제공하는 강력한 분산 클라우드/엣지 소프트웨어 플랫폼을 개발했다.

NXP 가 AWS 리인벤트에서 공개할 애플리케이션은 다음과 같다.

- AWS 트레이닝 및 엣지 추론을 활용한 지속적인 머신 러닝 기반의 안면 인식
- AWS IoT 및 AWS 그린그래스(AWS Greengrass) 서비스에 통합된 엣지 디바이스
- TSN(Time-Sensitive Networking)과 AWS 그린그래스 기반 프로세싱을 사용한 NXP 의 산업용 리눅스 플랫폼 OpenIL
- 수천 개 이상의 무선 연결 센서 노드 및 클라우드 연결을 지원하는 IoT 엣지 게이트웨이

타렉 부스타미(Tareq Bustami) NXP 수석 부사장은 "NXP 는 IoT 솔루션 구축을 위한 광범위한 MCU 및 MPU 디바이스 포트폴리오를 제공한다. 이러한 포트폴리오를 AWS 그린그래스와 같은 AWS IoT 서비스에 연결함으로써 보안과 효율성을 향상 시키고, 강력하고도 유연한 시스템을 구축할 수 있다"고 말했다.

데모 제품들은 아리아 쿼드(Aria Quad)에 마련된 NXP 부스(#200)와 디지 인터내셔널(Digi International) 부스(#209), 빌더스 페어(Builders Fair)에서 공개된다.

AWS 리인벤트 빌더스 페어에 선정된 레이어스케이프 기반 IoT 및 엣지 솔루션

리인벤트 행사 참가자들은 아리아 호텔에서 열리는 빌더스 페어에서 직접 제품을 체험해 볼 수 있다. NXP 프로젝트를 비롯해 45 개 이상의 프로젝트가 준비되어 있다. 빌더스 페어에서 선보일 레이어스케이프 기반 솔루션에는 다음 기능들이 포함된다.



- IoT 및 엣지 게이트웨이
- 산업용 IoT 를 위한 TSN
- AWS 그린그래스 통합
- AWS 의 트레이닝 및 추론(inferencing) 을 통한 안면 인식

NXP 반도체 소개

NXP® 반도체(나스닥: NXP)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 시큐어 커넥티드 카, 엔드 투 엔드 보안 및 프라이버시, 스마트 커넥티드 솔루션 분야의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 33개 이상의 국가에서 31,000명의 직원을 고용하고 있다. 2016년 매출은 미화95억불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (<http://blog.naver.com/nxpkor>) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.